

檔 號：

保存年限：

國家科學及技術委員會 函

機關地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：程稚茵
電話：02-2737-7232
傳真：02-2737-7619
電子信箱：parker@nstc.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國113年4月9日

發文字號：科會產字第1130023573號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2024未來科技獎徵件須知、「2024未來科技獎」暨參展報名資料表、2023未來科技獎獲選名單(附件1 113T0P001325_113D2009255-01.pdf、附件2 113T0P001325_113D2009257-01.pdf、附件3 113T0P001325_113D2009256-01.odt)

主旨：有關「2024台灣創新技術博覽會」辦理之未來科技獎徵件自即日起受理，請查照並轉知所屬踴躍報名。

說明：

- 一、旨揭博覽會將於113年10月17日(四)至10月19日(六)於台北世貿一館展出，以成為國際研發交易樞紐平台為定位，由11大部會展示前瞻技術能量，並邀請海外機構參展，共同展現我國創新技術能量。
- 二、徵件說明如下(請詳附件徵選須知)：
- 三、本案聯絡窗口：陳小姐，電話：(02)2576-2013、信箱：wenhua@mail.tca.org.tw

正本：專題研究計畫受補助單位 (共298單位)

副本：中央研究院、教育部、衛生福利部(以上均含附件)、本會各處室及所屬機關 (共26單位)、財團法人國家實驗研究院(含附件)、財團法人國家同步輻射研究中心(含附件)、國家災害防救科技中心(含附件)、國家太空中心(含附件)、台北市電腦商業同業公會(含附件)

113/04/10
08:57:05

主任委員吳政忠

國立中興大學



1130007336 113/04/10

「2024 未來科技獎」徵件須知

一、徵件目的：

- (一)盤點前瞻科研成果，展現我國科技實力。
- (二)鼓勵科研成果進軍全球市場、強化國際鏈結。

二、徵件資格：

- (一)須為國家科學及技術委員會、中央研究院、教育部、衛生福利部任一部會補助之計畫成果。
- (二)上述科研成果應符合以下技術領域範疇(一)化工、材料 (二)AIoT 智慧及生活應用(三)綠能環保、淨零科技 (四)電子、光電 (五)生技、新藥 (六)醫材 (七)人文、運動科技、科技藝術；為因應百工百業未來創新賦能需求，鼓勵半導體晶片、AI 相關新興應用及具有雛型之各類技術參與。



三、獲選獎勵：

- (一)得獎技術獲頒「2024 未來科技獎」獎盃 1 座、獎狀 1 張及獎金新臺幣 1 萬元整。
- (二)得獎技術若為國科會計畫，可列為計畫主持人申請國科會研究計畫加分項目。
- (三)於「2024 台灣創新技術博覽會-未來科技館」展中公開頒獎及展示技術，並獲得宣傳行銷及推廣媒合機會。
- (四)為促進海外交流合作，將另培訓及選送部份獲獎團隊前往海外參展，增加國際曝光及合作機會。
- (五)提供科研創業計畫或產學合作計畫之專業輔導及相關資源，協助獲獎技術商業化。

四、報名方式及時間：

(一)系統開放報名時間：由計畫主持人線上報名。

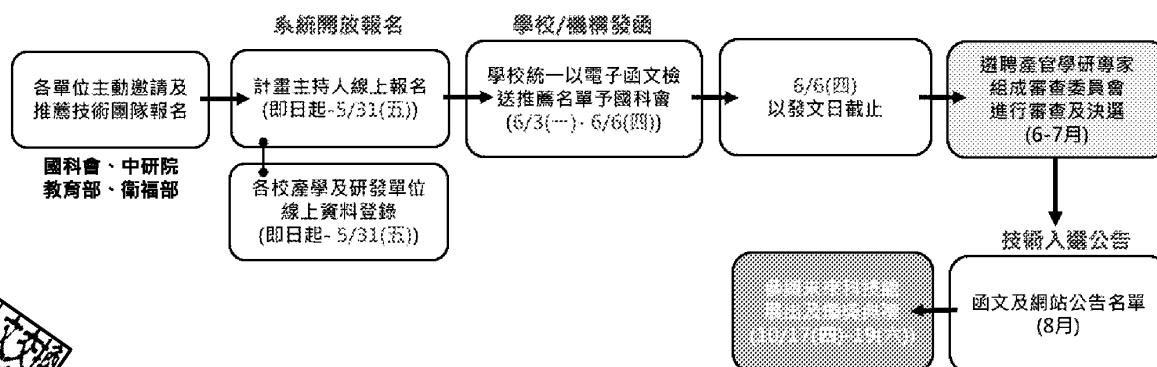
- 由計畫主持人自即日起至 5/31(五)23:59 止至未來科技館徵件網站 (<https://award.futuretech.org.tw/>) > [技術團隊] 註冊帳號或以前年度報名帳號登入。

(二)機構發函推薦：由計畫主持人所屬單位將推薦報名技術清單以電子公文函送國科會。

- 受補助學研單位之產學研發處人員，自即日起可至未來科技館徵件網址 (<https://award.futuretech.org.tw/>) > [產學窗口] 申請管理帳號，並於 6/3(一)起於該網址下載完整報名清單 [須勾選**推薦**]，確實掌握貴機構所有報名技術後，於 6/6(四)前以電子公文方式檢送報名清單予國科會，始完成報名作業。



五、評選流程：



、評選標準

(一)科學突破性(50%)：

1. 與國際 Benchmark 比較，該技術於全球具有領先性排名之領航地位。
2. 有別於既有思維、具原創性的科學研究或技術突破，並有可能在未來取代既有的延續性科技。

(二)產業應用性(50%)：

該技術與市場需求相容，能創造未來經濟效益，並具有產學合作、跨領域應用及建立創新模式之潛力，能促進民生社會福祉，帶動廣泛的市場應用規模。

七、其他注意事項：

(一)獲選技術應配合後續宣傳、參與實體展出、展後媒合調查回報等相關事宜。(如經查發現技術團隊實體展出三日皆無人員到場，將予以沒收獎金頒發資格。)

(二)「2024 台灣創新技術博覽會-未來科技館」展覽資訊如下。

1. 展出時間：10/17(四)-10/19(六)
2. 展出地點：台北世貿一館

(三)本會保留修改本辦法之權利，如有未盡事宜，悉依本會相關規定或解釋辦理。

(四)徵件技術之申請內容，涉有違反學術倫理情事者，依國家科學及技術委員會學術倫理案件處理及審議要點規定處理；並請尊重智慧財產權，違反者應負相關法律責任。

八、洽詢窗口：

未來科技館推動辦公室 陳小姐
信箱：wenhua@mail.tca.org.tw
電話：[\(02\)2576-2013](tel:0225762013)

「2023 未來科技獎」獲獎名單

■ 共 80 件技術

■ 上標¹為計畫主持人、上標²為計畫總主持人

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人 及共同主持人	補助部會
1	國立臺灣大學	臺大醫神-慢性病精準健康管理服務	賴飛熊 ¹ 、簡榮彥、 吳佳東、簡意玲	國家科學及技 術委員會
2	國立臺灣大學	虛擬實境滑板運動訓練系統	徐瑋勵 ¹ 、王兆麟、 賴達明、丁建均	國家科學及技 術委員會
3	國立臺灣大學	利用微型質譜儀進行即時癌症篩檢	徐丞志 ¹	國家科學及技 術委員會
4	國立臺灣大學	標靶葡萄糖轉運蛋白之小分子藥物應用於 癌症治療	梁碧惠 ^{1,2}	國家科學及技 術委員會
5	國立臺灣大學	半導體雷射量子密鑰分發與通信收發機	林恭如 ^{1,2} 、吳育任、 黃定洵、蘇國棟、吳 肇欣、巫朝陽	國家科學及技 術委員會
6	國立臺灣大學	安全有效的腸躁症腹痛首創型新藥	忻凌偉 ¹ 、余佳慧、 吳明賢	國家科學及技 術委員會
7	國立臺灣大學	用於主動預防感染、加速傷口癒合和無創癒 合監測的可穿戴自供電多功能模組	林宗宏 ¹	國家科學及技 術委員會
8	國立臺灣大學	極高介電係數開極堆疊整合於高層數堆疊 通道電晶體；堆疊奈米片鐵電場效電晶體； 銦鎵鋅氧開極環繞式奈米片電晶體	劉致為 ^{1,2} 、陳敏璋	國家科學及技 術委員會
9	國立臺灣大學	AI 輔助 3D 活細胞免染色定量顯微自動化拍 攝系統	駱遠 ¹	國家科學及技 術委員會
10	國立臺灣大學	高效產氫產氧雙功能非鉑全水分解電催化 觸媒	謝宗霖 ¹ 、何國川、 陳建彰、陳永松	國家科學及技 術委員會
11	國立臺灣大學	用於智能手錶之 24 小時日夜間血壓估測系 統	王宗道 ^{1,2} 、蔡佩芸、 林鴻儒、古博文	國家科學及技 術委員會
12	國立清華大學	實現氫能社會，前瞻三維非對稱過渡金屬硫 族化合物催化材料應用於高效率電化學綠 氫製造	闕郁倫 ¹	國家科學及技 術委員會
13	國立清華大學	智能網路導流之連續式蛋白質純化系統	黃振煌 ¹	國家科學及技 術委員會
14	國立清華大學	次世代高效肺臟基因遞送與催化轉染技術	胡尚秀 ^{1,2} 、張建文、 朱麗安、盧郁仁	國家科學及技 術委員會
15	國立清華大學	應用於自駕車與擴增實境之壓電式 MEMS 微 掃描面鏡開發	方維倫 ¹	國家科學及技 術委員會
16	國立清華大學	三維原子級電子斷層掃描技術在前瞻半導 體元件的應用	陳健群 ^{1,2} 、蕭健男、 吳文偉、吳永俊	國家科學及技 術委員會

「2023 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人 及共同主持人	補助部會
17	國立清華大學	單雷射光源無標定分子顯微影像系統	楊尚達 ¹ 、朱士維 ² 、 江安世、林彥穎	國家科學及技 術委員會
18	國立清華大學	深紫外表面增強共振拉曼散射 (SERRS) 基 板及其寡核苷酸中的單鹼基突變檢測	嚴大任 ¹	國家科學及技 術委員會
19	國立清華大學	發光二極體幫浦雷射	黃衍介 ^{1、2}	國家科學及技 術委員會
20	國立清華大學	常壓環境雷射耦合多相反應流體微奈米 3D 金屬/透明導電圖樣直析綠色製程	李明蒼 ¹ 、莊嘉揚	國家科學及技 術委員會
21	國立清華大學	非接觸式防疫技術 m' AI touch	陳鴻文 ¹	教育部
22	國立陽明交通大學	針內超音波胸腔區域麻醉定位導引系統	江惠華 ^{1、2} 、蘇府蔚、 丁乾坤	國家科學及技 術委員會
23	國立陽明交通大學	智慧型耐高溫一氧化氮氣體監測裝置	洪瑞華 ¹	國家科學及技 術委員會
24	國立陽明交通大學	垂直式溫差高通量精蟲分選晶片	李博仁 ¹ 、鍾成晏	國家科學及技 術委員會
25	國立陽明交通大學	具高解析電刺激、電生理訊號感測及細胞再 生治療之可降解植入式軟性微電極貼片	黃薇蓁 ^{1、2} 、彭志維	國家科學及技 術委員會
26	國立陽明交通大學	具動作平滑化之深度強化式學習技術與運 用其於自駕模型賽車駕駛應用	吳毅成 ^{1、2}	國家科學及技 術委員會
27	國立陽明交通大學	TAIMTAQ : 高效能 Transformer 邊緣運算 加速器晶片	黃俊達 ¹	國家科學及技 術委員會
28	國立陽明交通大學	多目標時間序列早期預測技術及急重症預 警應用系統	曾新穆 ^{1、2}	國家科學及技 術委員會
29	國立陽明交通大學	應用微型生物電腦於複雜疾病監控	陳溼州 ^{1、2}	國家科學及技 術委員會
30	國立陽明交通大學	大面積、高效率、CMOS 製程兼容的超穎透鏡	余沛慈 ^{1、2} 、謝嘉民、 張祐嘉、楊尚樺、黃 耀緯	國家科學及技 術委員會
31	國立陽明交通大學	毫米波雷達系統降干擾技術	管延城 ¹ 、唐震寰 ² 、 劉志尉	國家科學及技 術委員會
32	國立陽明交通大學	環境污染物之細菌降解：專利菌株與應用	黃雪莉 ¹	國家科學及技 術委員會
33	國立陽明交通大學	透視羽球-控球力評估系統	易志偉 ¹	國家科學及技 術委員會
34	國立成功大學	新穎鍍鎳硫粉儲能材料於高能量密度商用 電池	鍾昇恆 ¹	國家科學及技 術委員會

「2023 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人 及共同主持人	補助部會
35	國立成功大學	周邊神經肌肉系統植入式電刺激治療平台之開發	薛元毓 ^{1,2}	國家科學及技術委員會
36	國立成功大學	胃腸道止血粉末及其輸送器材系統	林錫璋 ^{1,2} 、莊喬雄、 陳柏潤、姜學謙	國家科學及技術委員會
37	國立成功大學	多重條碼微珠平台並應用於血清學檢測	許觀達 ¹ 、何宗憲、 張天豪、蔡田峻、蔡 佩珊	國家科學及技術委員會
38	國立成功大學	基於電腦視覺的自動化焊接人機協作系統	沈揚庭 ^{1,2} 、連震杰、 劉光晏	國家科學及技術委員會
39	國立成功大學	以氫代碳：富氫高爐數位孿生系統	林士剛 ^{1,2} 、謝克昌、 紀渥德	國家科學及技術委員會
40	國立成功大學	30 kVA 具電網形成技術之儲能換流器	梁從主 ^{1,2}	國家科學及技術委員會
41	國立成功大學	B型肝炎病毒新穎指標檢測平台開發與臨床治療應用	黃溫雅 ^{1,2}	國家科學及技術委員會
42	國立成功大學	超高解析度超音波向量血流造影技術	黃執中 ^{1,2}	國家科學及技術委員會
43	國立成功大學	新穎式奈米複合粒子 FFP 於奈米放射免疫療法的應用及開發	蔡宗霖 ¹ 、吳炳慶、 吳尚殷	國家科學及技術委員會
44	國立成功大學	圖機器學習之對抗式個資隱私攻防	李政德 ^{1,2}	國家科學及技術委員會
45	國立成功大學	應用於心臟疾病診斷之無線生理檢測晶片系統與平台	李順裕 ^{1,2} 、陳儒逸、 謝孟達、黃春融、陳 芃婷	國家科學及技術委員會
46	國立成功大學	次世代運動體驗-智聯羽球場館解決方案	王振興 ^{1,2}	國家科學及技術委員會
47	國立中央大學	以晶圓鍵合轉換界面功能加速陽極氧化半導體材料	李天錫 ¹	國家科學及技術委員會
48	國立中央大學	多人混合實境即時互動遠端算繪平台	黃志煒 ¹ 、孫慶成 ² 、 陳建隆、余業緯、楊 宗勳	國家科學及技術委員會
49	國立中興大學	流體化床均質結晶技術回收廢水中重金屬	盧明俊 ¹ 、黃耀輝	國家科學及技術委員會
50	國立中興大學	高值化智能環境友善肉品即時鮮度指示系統研發與應用-農業廢棄物環境友善加值應用技術	林耀東 ^{1,2} 、黃振文、 吳俊霖、譚發瑞、翁 誌煌	國家科學及技術委員會

「2023 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人 及共同主持人	補助部會
51	國立中興大學	全方位 SERS 檢測平台 CSDP-生醫和食安應用	張健忠 ^{1,2} 、詹富智、黃俊達、王國禎	國家科學及技術委員會
52	國立中興大學	低碳米-導入 AIoT 的減碳水稻收穫模式	楊明德 ¹ 、林俊良 ² 、許鈺群、賴明信	國家科學及技術委員會
53	國立中山大學	淨零碳排:低成本鹼性海水產氫元件與技術	陳軍互 ¹	國家科學及技術委員會
54	國立中山大學	應用於驅動三軸光纖陀螺儀之多功能矽光子積體電路	洪勇智 ¹ 、魏嘉建	國家科學及技術委員會
55	國立中山大學	具隱私保護暨安全資料探勘之醫療資料倉儲系統	范俊逸 ^{1,2} 、楊宗龍、莊承鑫、徐瑞壕、克拉迪(Arijit Karati)	國家科學及技術委員會
56	國立中正大學	矽光子關鍵光源技術: 單晶整合矽基四族雷射	張國恩 ¹	國家科學及技術委員會
57	國立中正大學	環境友善可重構智慧面之電磁感測技術	張嘉展 ¹ 、張盛富 ² 、林士程、劉立頌	國家科學及技術委員會
58	國立臺灣科技大學	整合數位灰階、失焦法及新開發光固化樹脂於立體微影積層製造技術上,用於超高速製造高光學性能之微透鏡陣列	陳品銓 ¹	國家科學及技術委員會
59	國立臺灣科技大學	全紙基環境吸濕產電電池	葉禮賢 ¹	國家科學及技術委員會
60	國立臺北科技大學	易動拳靶:結合遭受型觸覺回饋技術於沉浸式拳擊訓練之替代實境機器人	韓秉軒 ¹ 、邱文信 ²	國家科學及技術委員會
61	國立雲林科技大學	太陽能模組 EL 及 IR 熱斑瑕疵自動檢測技術	張傳育 ^{1,2}	教育部
62	國立高雄科技大學	具 IoT 智能監測的可攜式微型塑膠射出成型機	鄭瑞鴻 ¹ 、方得華	國家科學及技術委員會
63	臺北醫學大學	運用生成式深度學習預測晚期肺癌藥效預後和篩選全球臨床試驗	陳震宇 ^{1,2} 、張詠淳、蕭世欣	國家科學及技術委員會
64	國防醫學院	IgA 腎病變之自體抗體源頭診斷	賈淑敏 ¹ 、李雨青、吳家兆、楊智宇、陳安	國家科學及技術委員會
65	中國醫藥大學	重組片段人類肺泡表面蛋白 D 對慢性阻塞性肺病的診斷及治療應用	王志堯 ^{1,2} 、歐芷瑩、高慧芳	國家科學及技術委員會
66	中國醫藥大學附設醫院	可異體移植的雙靶向奈米抗體 CAR. BITE- γ δ T 細胞治療技術	黃士維 ¹ 、周德陽、邱紹智	國家科學及技術委員會

「2023 未來科技獎」獲獎名單

序號	申請機構	參展技術名稱	計畫(總)主持人 及共同主持人	補助部會
67	中國醫藥大學附設醫院	石墨烯為主之多功能材料於標靶偵測、診斷與治療的應用	郭文碩 ¹ 、王志堯 ² 、張家源、吳尚蓉、吳炳慶、吳世欣	國家科學及技術委員會
68	逢甲大學	駕馭超進化之智慧電子避震系統	林昱成 ^{1,2} 、陳文輝、尤正吉、陳世綸、洪三山	國家科學及技術委員會
69	慈濟大學	藉由具有蛋白質表現於其表面之囊泡遞送藥劑至自噬及凋亡細胞	孫德珊 ¹ 、張新侯	國家科學及技術委員會
70	明志科技大學	極弱光成像技術：捕捉不可見光之穿戴式眼鏡	劉舜維 ^{1,2} 、李君浩、黃裕清	國家科學及技術委員會
71	中央研究院	沉浸式視覺藝術互動系統	古倫維 ¹ 、黃靖家	國家科學及技術委員會
72	中央研究院	真空/極紫外光偵測與成像器之開發	張煥正 ¹ 、鄭炳銘	國家科學及技術委員會
73	原子能委員會核能研究所	軟性可透光有機太陽能電池模組之設計與低碳溶液印刷量產製程	曹正熙 ¹ 、馬維揚	國家科學及技術委員會
74	財團法人國家衛生研究院	發展 HEK293 細胞製程用於克沙奇疫苗生產	劉家齊 ¹ 、周彥宏	衛生福利部
75	長庚醫療財團法人	腹腔異常游離氣體深度學習檢測方法及檢測系統	薛承君 ¹ 、郭昶甫、范佐搖、陳嶽鵬、王俐人	國家科學及技術委員會
76	長庚醫療財團法人	無創式超音波腦部診斷治療輔助系統	魏國珍 ¹ 、劉浩澧、楊閱蔚	國家科學及技術委員會
77	臺北榮民總醫院	創新智能聽力檢測系統：提早發現潛藏性聽損，助於早期治療	廖文輝 ^{1,2} 、朱原嘉、賴穎暉	國家科學及技術委員會
78	臺北榮民總醫院	神經科技新療法~整合腦部磁刺激與虛擬實境語言認知訓練系統	蔡泊意 ^{1,2} 、葉士青	國家科學及技術委員會
79	臺中榮民總醫院	人工智慧急性腎損傷預測：即時推論互動重症照護系統	陳適安 ^{1,2} 、吳杰亮、李政鴻、許瑞愷	國家科學及技術委員會
80	亞東紀念醫院	One Model Fit All: 心肌灌注掃描免常模一站式冠狀動脈狹窄預測系統	吳彥雯 ^{1,2} 、陳中明、柯紀綸	國家科學及技術委員會

「2024 未來科技獎」暨參展報名資料表

線上登錄網址：<https://award.futuretech.org.tw/>

一、技術團隊基本資料

*為必填欄位

※請依當初申請補助計畫填列之申請單位及計畫團隊成員資料填寫

申請單位名稱全名 (中文)*	ex: 國立臺灣大學			
申請單位名稱全名 (英文)*	ex: National Taiwan University			
單位統一編號*				
單位地址(中文)*				
單位地址(英文)*				
單位網址				
計畫總主持人 (無則免填) *將列名於獲獎名單中			單位名稱	
部門/科系 信箱			職稱	
計畫主持人* *將列名於獲獎名單中			單位名稱*	
部門/科系*			職稱*	
連絡電話*	ex: 02-2578-6427	分機	手機*	
信箱*				

計畫共同主持人 <small>(無則免填，可自行增加欄位，至多4位)</small> <small>*將列名於獲獎名單中</small>		單位名稱	
職稱		信箱	
聯絡人(中文)*		聯絡人(英文)*	
職稱(中文)*		職稱(英文)*	
部門/科系*		聯絡電話* <small>ex: 02-2578-6427</small>	分機
手機		信箱*	

二 技術內容

技術名稱*	中文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱
	英文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱
技術來源*	<input type="checkbox"/> 國家科學及技術委員會 <input type="checkbox"/> 中央研究院 <input type="checkbox"/> 教育部之公私立大專院校 <input type="checkbox"/> 衛生福利部 計畫編號：_____，計畫名稱：_____ (請詳列年度/計畫全名) 計畫經費：_____萬元 *請勿輸入千分位分隔符號(.) 補助單位：(下拉式選單) <input type="checkbox"/> 自然科學及永續研究發展處 <input type="checkbox"/> 工程技術研究發展處	

	<input type="checkbox"/> 生命科學研究發展處 <input type="checkbox"/> 人文及社會科學研究發展處 <input type="checkbox"/> 科教發展及國際合作處 <input type="checkbox"/> 前瞻及應用科技處 <input type="checkbox"/> 產學及園區業務處 <input type="checkbox"/> 綜合規劃處 <input type="checkbox"/> 若無計畫編號，請提供專案或補助計畫名稱：_____ (請詳列:補助部 會/年度/專案及計畫全名/計畫經費)
資料類別*	<input type="checkbox"/> 技術 <input type="checkbox"/> 專利 <input type="checkbox"/> 其他_____
技術 TRL 等級 * (單選)	<input type="checkbox"/> TRL1 <input type="checkbox"/> TRL2 <input type="checkbox"/> TRL3 <input type="checkbox"/> TRL4 <input type="checkbox"/> TRL5 <input type="checkbox"/> TRL6 <input type="checkbox"/> TRL7 <input type="checkbox"/> TRL8 <input type="checkbox"/> TRL9_
獲獎紀錄*	<input type="checkbox"/> 是，請條列本技術相關獲獎紀錄(含獲獎年度) <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> <input type="checkbox"/> 否
技術類別* (單選)	<input type="checkbox"/> 化工、材料 <input type="checkbox"/> 電子、光電 <input type="checkbox"/> AIoT 智慧及生活應用 <input type="checkbox"/> 生技、新藥 <input type="checkbox"/> 醫材 <input type="checkbox"/> 綠能環保、淨零科技 <input type="checkbox"/> 人文、運動科技、科技藝術
參選技術是否與 下列領域議題相關	<input type="checkbox"/> 半導體 <input type="checkbox"/> AI 應用 <input type="checkbox"/> 淨零排放 <input type="checkbox"/> 精準健康 <input type="checkbox"/> 無關聯
是否已登記成立 新創公司*	<input type="checkbox"/> 是，登記公司名稱：_____ <input type="checkbox"/> 否
技術說明(中文)* (限 1000 字元數，含空白)	
技術簡介(中文)* (限 150 字元數，含空白)	

	※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制
技術說明(英文)* (限 2000 字元數，含空白)	
技術簡介(英文)* (限 500 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制
技術之科學* 突破性(中文) (限 1000 字元數，含空白)	※此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述
技術之科學* 突破性概述(中文) (限 50 字元數，含空白)	※此欄內容將作為技術手冊編排使用，故有字數限制
 技術之科學* 突破性概述(英文) (限 500 字元數，含空白)	※此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述
技術之產業應用性* (中文) (限 1000 字元數，含空白)	

		※此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述			
技術之產業應用性 概述(中文)* (限 150 字元數，含空白)		※此欄內容將作為技術手冊編排使用，故有字數限制			
技術之產業應用性 概述(英文)* (限 500 字元數，含空白)		※此欄包含產業應用潛力、應用對象、應用業別，及技術未來能創造之經濟效益			
技術展示方式* (限 1000 字元數，含空白)		※請詳細描述技術展示方式，包含 Prototype 展示方式、互動可能性，如有實體展示請描述物品大小 (長*寬*高)			
技術關鍵字* (中文)		※請提供 10 組中文關鍵字，供媒合廠商透過關鍵字，精準快速搜尋此技術			
技術關鍵字* (英文)		※請提供 10 組英文關鍵字，供媒合廠商透過關鍵字，精準快速搜尋此技術			
專利保護 狀況 (非必填)	申請中	申請國別	專利類型	申請號	
	已獲證	核准國家	專利類型	證書號碼	專利權止日
流通方式* (可複選)		<input type="checkbox"/> 專利非專屬授權 <input type="checkbox"/> 專利專屬授權 <input type="checkbox"/> 專利讓與 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 合作開發 <input type="checkbox"/> 其他_____			

<p>首次發表*</p> <p>(單選)</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>※如技術尚未於任何公開形式發表過，即為首次發表</p>																																																																								
 <p>技術發明人*</p> <p>(請依實際貢獻核實填列。</p> <p>可自行增加欄位，至多10組)</p>	<p>發明人數：_____ (至多10位)</p> <p>*英文姓名格式：名在前、姓氏在後。名字音節中間以短橫區隔。 ex：王小明 SIAO-MING WANG</p> <table border="1" data-bbox="405 439 1457 1317"> <thead> <tr> <th colspan="2">姓名</th> <th colspan="2">單位</th> <th colspan="2">職稱</th> </tr> <tr> <th>中文</th> <th>*英文</th> <th>中文</th> <th>英文</th> <th>中文</th> <th>英文</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	姓名		單位		職稱		中文	*英文	中文	英文	中文	英文																																																												
姓名		單位		職稱																																																																					
中文	*英文	中文	英文	中文	英文																																																																				
<p>技術/產品圖片*</p>	<p>請上傳3張圖片，規格為 jpg、png、gif、1024*768 像素(150dpi)含以上，500kb 以內</p>																																																																								
<p>技術影片(非必填)</p>	<p><input type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有，影片連結：_____</p>																																																																								
<p>附件資料</p>	<p><input type="checkbox"/>無</p> <p><input type="checkbox"/>有，上傳附件佐證資料，如計畫書、國際期刊、專利或其他可加分之佐證資料。(請先將相關佐證資料統一輸出成乙份 PDF 檔案，檔案大小限制於 5M 內)</p>																																																																								
<p>備註</p>																																																																									

